

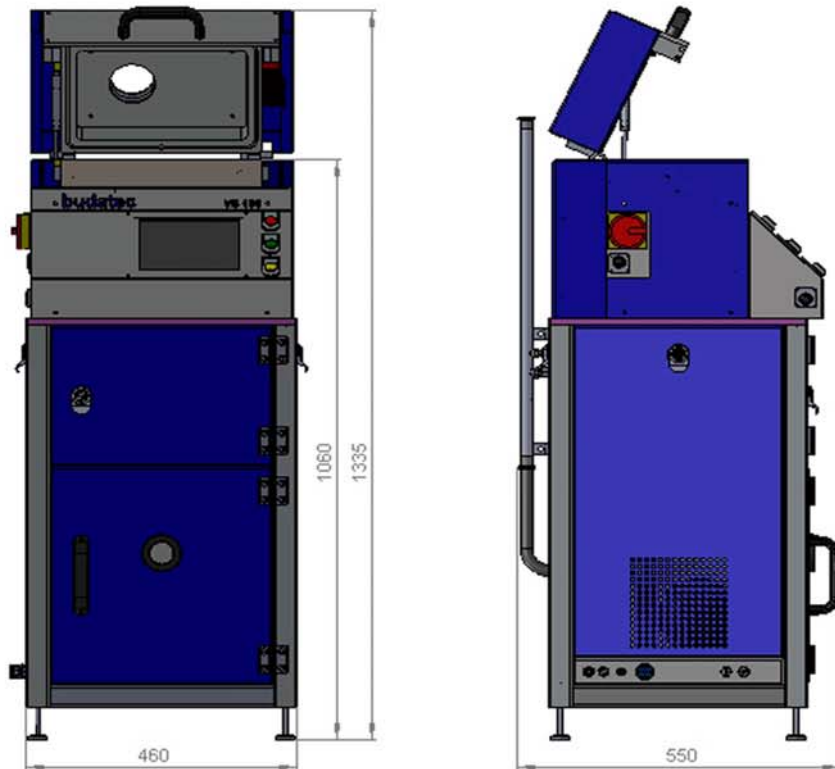
VS 160UG Vacuum Soldering System



budatec

Equipment for semiconductor and photovoltaics industries

Abmessungen:



Technische Daten:

Heizplattengröße:	160mm x 160mm
max. Bauteilhöhe:	50mm
max. Löttemperatur:	450°C
Aufheiz- und Abkühlraten:	max. 3 K/s
max. Heizplattenbeladung:	2,5 kg
Prozessgas:	Stickstoff und Formiergas
Stromversorgung:	400V / 16A
Kühlwasseranschluß:	10 slm
Masse der Anlage:	ca. 80 kg

Optionen:

Absolutdruckmessung
Drehschieberpumpe mit Zubehör (Adsorptionsfalle/Auspufffilter)
Software für Datalogging
Untergestell mit Gaseinspeisung und Adaptionmöglichkeit für die Pumpe
HCOOH-Gaslinie mit integriertem Bubbler